

中国材料研究学会

材学办〔2026〕04号

中国材料大会 2026 会议通知 (第二轮)

“中国材料大会”是中国材料研究学会的学术年会，是国家级品牌大会，是中国新材料界学术水平最高、涉及领域最广、前沿动态最新的创新发展大会，是瞄准国家重大需求，汇聚高端智力资源，聚焦行业共性“堵点”，奋力推进跨领域、跨行业协同创新，打造面向全球的中国新材料学术与产业高地，全方位服务十五五战略实施，推动我国新材料前沿重大突破，集中力量服务“材料强国建设”的大会。

中国材料大会 2026，于 2026 年 7 月 **11-14** 日在湖北省武汉市**武汉国际博览中心**举办。大会设大会报告、分会交流、Poster 展示以及论文出版等多种交流形式。本届大会分会主题涵盖能源材料、信息材料、先进结构材料、功能材料与器件、生物医用材料、衣食住行材料、环境材料、安全材料、“人工智能+材料”、再生新材料、材料加工制备及表征、生物质材料等。本届大会按照国家亟需增设高端特色论坛：2026 知名高校材料院长论坛、新概念材料与前沿交叉科学发展 2050 高层论坛、青年科学家论坛、青年科学家非共识论坛、青托、青培材料论坛暨第四届青托党校、

青年学者前沿闪报大讲台等特色新材料论坛，2个 AI+新材料高级研修班，1个学术论文与基金写作能力提升班等。

会议主要内容如下：

一、组织机构

主办单位： 中国材料研究学会

二、重要日期

7月 11-14日，会议报到、交流

6月 5日 12:00，系统摘要提交截止

6月 22日 17:00，注册费优惠截止

三、分论坛设置

A-能源材料

A01-能源转换与存储材料

A02-高熵能源催化材料

A03-核材料

A04-太阳能材料与器件

A05-油气田及新能源材料

A06-纳米材料合成及光/电催化应用

A07-有机/钙钛矿太阳能电池材料

A08-水系电池及关键材料

A09-极端合成与新材料

A10-钠离子电池材料

A11-固态电池及关键材料

A12-先进分离膜与多孔材料

A13-AI+先进能源材料与器件前沿

A14-AI 驱动能源材料化学与化工协同创新

B-环境材料

B01-光催化材料

B02-生态环境材料

B03-环境功能材料

B04-资源材料与循环利用

B05-环境分离净化材料与技术

B08-矿物功能材料

C-结构材料

C01-粉末冶金

C02-高性能铝合金

C03-镁及镁合金

C04-高温合金

- C05-高性能钛合金材料
- C06-金属基复合材料
- C07-空间材料科学技术
- C08-超高温结构材料与防护涂层
- C09-先进结构陶瓷的制备与表征
- C10-微结构与强韧化
- C11-冲击环境材料技术
- C12-兵器材料科学与技术
- C13-先进钢铁材料
- C14-结构材料热-动力学
- C15-水泥与混凝土材料
- C16-极端环境材料特种制备与性能
- C17-核石墨
- C18-先进粉末冶金材料与技术
- C19-难熔金属
- D-功能材料**
- D01-超材料与多功能材料
- D02-多铁性材料
- D03-非晶与高熵合金
- D04-刺激响应功能材料
- D05-纤维素工程与技术
- D06-先进微电子与光电子材料
- D07-生物医用材料
- D08-纳米多孔金属材料
- D09-纤维材料改性与复合技术
- D10-高分子材料
- D11-电子材料与微系统
- D12-先进磁性功能材料
- D13-水凝胶材料
- D14-碳点功能材料
- D15-先进涂料
- D16-微纳能源器件及关键材料
- D17-智能传感功能材料与器件
- D18-仿生材料
- D19-液态金属材料
- D20-多孔吸附与催化
- D21-多尺度结晶光电材料及器件
- D23-磁流体-磁流变
- D24-功能分子材料与器件
- D25-纳米信息功能材料
- D26-智能分子材料
- D27-二维材料与器件
- D28-电化学功能材料
- D29-多孔材料制备及应用
- D30-先进半导体光电材料与器件
- D31-先进电工材料
- D32-润滑密封与耐磨材料
- D33-原子级制造与智能传感
- D34-功能薄膜
- D35-含能材料

D36-热管理材料

D37-运动健康新材料

D38-无机光电功能材料

D39-超导材料与应用

D40-柔性电子材料与器件

D41-类脑计算材料与器件

D42-电磁屏蔽与吸收材料

D43-人工晶体生长与器件应用

D44-量子材料

D45-超晶格

D46-超分子材料

D47-核酸功能材料

D49-石墨炔可控合成、理论及应用

D50-关键金属

D51-碳基材料

D52-精准诊疗关键材料

D53-智能医药材料与器件

D54-极端条件下材料与器件

D55-纳米材料与器件

E-材料模拟、制备与评价

E01-材料先进制备加工技术

E02-材料界面/表面分析与表征

E03-相分离冶金与材料

E04-先进凝固科学与技术

E05-材料微结构加工与先进合金化技术

术

E06-材料基因与人工智能材料

E07-增材制造材料

E08-超声材料科学与技术

E09-材料表面工程

E10-材料结构与性能表征技术

E11-中子源与同步辐射先进材料表征技术

E12-人工智能化学与材料学

E14-先进催化材料与技术

E15-微细加工与成形及晶体塑性力学应用

E17-相场理论与应用

P-高分子材料老化与服役寿命研究

Z-材料模拟、计算与设计

F-青年科学家论坛

FA-青托、青培材料论坛暨第四届青托党校

FB01-材料介观方法青年科学家论坛

FB02-新体系电池青年科学家论坛

FB03-低维轻元素材料与器件青年科学家论坛

FB04-先进材料连接与焊接科学青年科学家论坛

FB05-青年科学家非共识论坛

FB06-人工智能与物质科学青年科学家论坛
FB07-后摩尔新出路
FB08-青年学者前沿闪报大讲台
FC-特色材料论坛
FC01-2026 知名高校材料院长论坛
FC02-AI+结构材料高级研修班
FC03-AI+功能材料高级研修班
FC04-学术论文与基金写作能力提升班
FC05-文化遗产材料分论坛
FC06-科普夏令营
FC08-新概念材料与前沿交叉科学发展 2050 高层论坛

四、投稿与出版

（一）摘要提交

1. 参会摘要请于 2026 年 6 月 5 日 12:00 前在大会官网按提示提交至系统，无需模版。摘要经大会组委会及各分会评审后录用，并制作电子论文摘要集；

2. 摘要内容须完整，包含所采用的材料和研究技术的主要信息、得到的主要结果、得出的主要结论等；

3. 摘要内容不能包括图、表、公式等；

4. 摘要语言依分会要求确定；

5. 摘要的提交仅为本次会议使用；

6. 摘要根据参会代表需求提交，非必须。

（二）论文出版

1. 本次会议将出版会议论文集，凡内容符合大会主题范围、未在国内正式刊物或其他会议上发表的论文，均可投递全文，分会自行出版的由分会负责；

2. 除会议论文集外，本次会议还设两本新刊收稿，不收取版面费，期刊信息如下：

《*Review of Materials Research*》和《*Transactions of Materials Research*》由中国材料研究学会与 Elsevier 合作创办。

《*Review of Materials Research*》征文范围：

- (1) Flash Reports of Current Research.
- (2) Concise Reviews of Materials Research.
- (3) Comprehensive Survey of Materials Progress.
- (4) Commentary from Materials Research Society.

《*Transactions of Materials Research*》征文范围：

- (1) Materials Frontier and Interdisciplinary Science.
- (2) Metallic Materials Science and Technology.
- (3) Inorganic Materials Science and Technology.
- (4) Polymer Materials Science and Technology.

3. 经大会组委会评审后，符合要求的中文论文将以《中国材料大会 2026 会议论文集》形式，由《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社网络出版，由《中国重要会议论文全文数据库》及 CNKI 系列数据库收录；

符合要求的英文论文将发表至以下刊物：

《*Journal of Physics: Conference Series*》(EI 收录, Online ISSN: 1742-6596)

《*Springer Proceedings in Materials*》(EI 收录, ISSN: 2662-317X)

优秀论文可推荐至以下优质期刊：

《*Progress in Natural Science: Materials International*》
(SCIE, IF=7.1)

4.论文出版服务对象为缴纳过注册费的参会代表，且在论文被录用后，需缴纳版面费（不用缴纳版面费的论文除外）；

5.提交全文时，务必备注所选刊物，否则均默认为会议论文集出版；

6.全文提交截止日期：7月22日。

五、注册与注册费

（一）会议网址

会议官网：<https://cmc2026.scimeeting.cn>



会议期间，食宿统一安排，费用自理。

（二）注册费标准（不含版面费）

类别	2026年6月22日 17:00前缴费	2026年7月10日 前缴费	2026年7月11-14 日现场缴费
学生	1000元	1500元	1800元
非学生	2000元	2500元	2800元

团体（≥10人）报名缴费，享免团体中任一人注册费优惠政策，该团体中所有成员须在同一注册费标准期内缴费，且缴费后不接受退费。

如为网上银行汇款，缴费日期以汇款日期为准。

备注：优惠截止日期前注册且选择现场缴费，但未缴费的参会代表不享受注册费优惠政策。

六、酒店预订

扫描二维码进行酒店预订：

- 1.建议各位代表尽早自行预订会议期间住宿。
- 2.凡在大会平台预定房间的代表，可为您提供酒店与会场之间的免费早晚班车。请会议期间，关注酒店前台班车信息。



七、联系方式

1.参会咨询

电话：010-68710443，闫老师 15712976428

邮箱：cmc_public@126.com

2.财务咨询

电话：010-61196085、李老师 13520198012（微信同号）、
孙老师 13520675663（发票、汇款）

3.论文咨询

电话：刘老师 15210936650、王老师 18519046547

4.展览、赞助咨询

电话：王老师 15611013638

